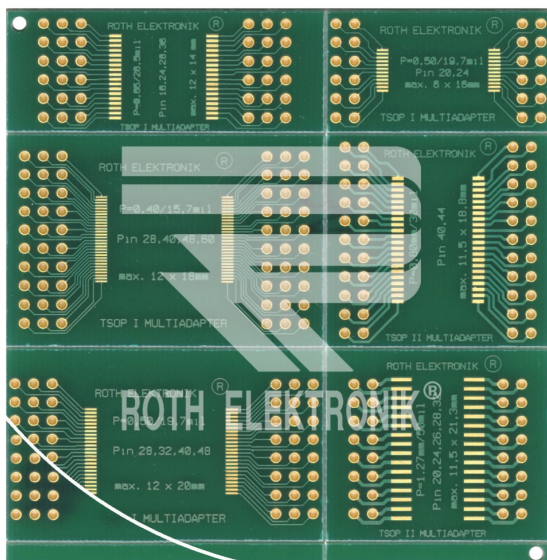


SMD-TSOP I/II Multiadapter



RE900



- Epoxyd FR4 1,50 mm, zweiseitig 35 µm CU (durchkontaktiert)
- Löt- und Komponentenseite mit einer Oberfläche aus chem. Nickel/Gold (Ni/AU) sowie Lötstopmaske
- Pitch Abstände:
0,40 mm (15.7 mil); 0,50 mm (19.7 mil)
0,65 mm (26.5 mil); 0,80 mm (30 mil); 1,27 mm (50 mil)
- Lochdurchmesser 1,00 mm
- Adaptionplatine für 14 verschiedene SMD TSOP I und 7 verschiedene SMD TSOP II Chips
- Vorgerritzte Sollbruchstellen zum Trennen einzelner Module von der Platine
- Gerberdaten zur Herstellung des Lötpastenaufdrucks werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt
- Größe 72,60 x 76,20 mm

Modul-Nr	Typ	Pitch	Pin/Anz.	Gehäuse max./mm
RE900-01	TSOP I	0,40	28,40,48,60	12 x 18
RE900-02	TSOP I	0,50	28,32,40,48	12 x 20
RE900-03	TSOP I	0,50	20,24	6 x 16
RE900-04	TSOP I	0,65	16,24,28,36	12 x 14
RE900-05	TSOP II	0,80	40,44	11,5 x 18,8
RE900-06	TSOP II	1,27	20,24,26,28,32	11,5 x 21,3